

用于金线及其他检测领域的 AOI及AXI

X7056-II BO 检测系统有效结合了光学在线金线检测和自动 X 光检测。这一全面的检测方案实现了更高的效率、优化了周期时间并借此提高了产量。此外，价格和购买两台独立设备相比有很大优势。

Viscom 检测软件专为最高的检测深度及精度而设计。在标准库中已有针对线模连接、球、楔或安全连接的检测模板。检测范围可根据个性化要求扩展。高分辨率的光学相机技术可在检测过程中采集所有连接点和金线的图像和信息。自动 X 光检测能无缝对接。借此便能在一次筛查流程中可靠地检测被遮盖的连接点。

检测内容包括走线、线模和元件位置的质量。不管是铜、铝或金组成的连接，或者是带状、线或细线。部件破损和位置偏移同样也能可靠探测。

在这一设备中，Viscom也在所有范畴内提供性能完善的维修验证、离线编程和SPC评估。

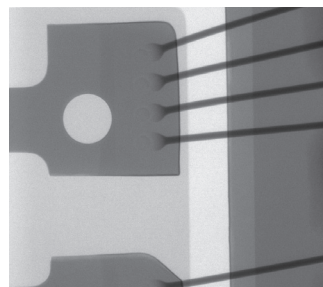
在单一设备中进行AOI
和AXI的绑定检测

性能完善的Viscom
检测软件

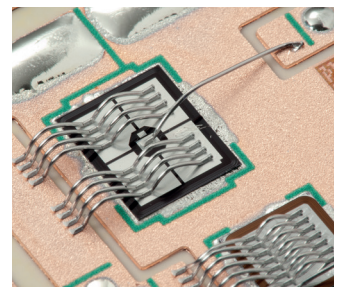
超高精度及检测深度

可针对粗线和细线灵活选
择相机模块

免维护封闭式
微聚焦 X 光管



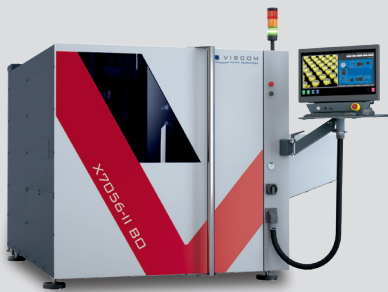
金线检测基于X光图片



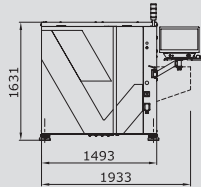
识别多线连接和多个回路的缺陷

Bond

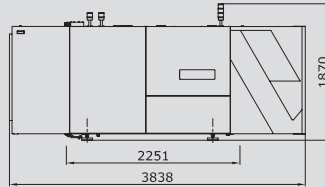
技术数据



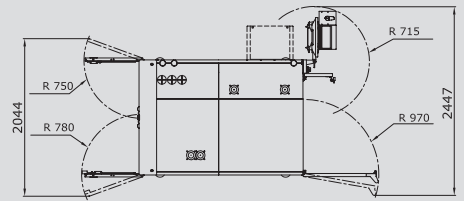
前视图



侧视图



俯视图



单位: mm

X7056-II BO

X 光技术	X 光管	封闭式 X 光管
	高压	60 - 130 kV
	管电流	50 - 300 μ A
	探测器	平板探测器 (FPD), 14 位灰阶深度
	分辨率	6 - 30 μ m/像素 (取决于配置)
	X 光机箱	根据辐射保护法 (StrSchG) 及辐射保护法规 (StrlSchV) 的高标准要求设计。 辐射泄漏率 < 1 μ Sv/h
相机技术*	XM Bond HR 模块 - 正交摄像头	
	图像大小	23 mm x 23 mm
	分辨率	4,5 μ m
	百万像素摄像头数量	1
软件	操作界面	Viscom EasyPro/vVision-ready
	验证维修站	Viscom HARAN
	SPC	Viscom SPC (统计进程控制), 开放式界面 (选配)
	远程诊断	Viscom SRC (软件远程控制) (选配)
	离线编程	Viscom PST34 (外部编程站) (选配)
	系统缺陷分析及持续系统监测	Viscom PDC (过程数据控制), TCM (技术链管理)
系统计算机	操作系统	Windows®
	处理器	Intel® Core™ i7
基座处理	基座尺寸	最大 450 mm x 350 mm (长 x 宽)
	处理高度	850 - 980 mm \pm 20 mm
	基座固定	气动
	基座放置宽度	3 mm
	上方净空高度	最大 25 mm; FPD 分辨率 8 μ m: 20 mm
	下方净空高度	50 mm
	处理时间	\geq 4 s (带有 xFastFlow)
其他系统数据	行走/定位单元	同步线性马达
	接口	SMEMA, SV70, 客户特定
	电源要求	400 V (其他电压请具体洽询), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 8 bar 工作压力
	系统尺寸	1493 mm x 1631 mm x 2251 mm (宽 x 高 x 长)
	生产线集成尺寸	+25 mm
	重量	2245 kg

*其他摄像头模块欢迎洽询。

本公司保留更改技术资料的权利。Windows® 和 Intel® Core™ i7 是注册的商品标识。